

厦门光莆电子股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：20251021

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☒ 其他（投资者线下调研）
参与单位名称及人员姓名	七星投资、中信建投证券、瑞达期货、华夏银行及社会投资者
时间	2025年10月21日 15:30-17:30
地点	厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道1800-1812号
上市公司接待人员姓名	董事：林瑞梅女士 副总经理、董事会秘书：张金燕女士
投资者关系活动主要内容介绍	1. 请介绍一下公司未来的发展方向？是否涉及低空经济、无人机等领域？ 答:公司将紧抓全球产业链重构、国产替代加速及双碳目标机遇，坚持国际+国内双轮驱动，聚焦半导体光集成传感器主业，深化半导体光技术创新，强化跨国经营能力，拓展数智能碳管理业务，通过内生+外延双重赋能，打造全自主可控的“光集成传感器封测-智能传感模组-智能终端产品-场景解决方案”产业链闭环，实现生态乘数效应。 公司积极拓展光集成传感器件、智能传感模组在机器人、低空飞行、智能驾驶、可穿戴设备等高成长、迭代快的领域应用，光集成传感器封装产品目前已在机器人、无人机、智能手机、智能驾驶、消费电子等多个领域应用。 2. 请教一下，目前公司与科技相关的国内高校有哪些合作？方便透露吗？ 答:公司积极联动国内高校、科研院所及高端人才团队，构

	建开放协同、优势互补的创新生态体系：（1）与中国科学院半导体研究所联合申报了“十四五”重大科技攻关项目，依托双方在产业落地经验与前沿科研资源上的优势互补，共同推进技术研发与成果转化；（2）与厦门大学建立长期稳定的合作关系，搭建联合人才培养平台，通过共建实验室、联合开展课题研究、设立实习实践基地等多元形式，实现学术研究与产业需求的精准对接，为公司持续输送高素质、复合型专业人才，夯实人才储备基础；（3）积极携手院士科研团队，探索“脑机接口”等具有前瞻性、战略性的新兴技术方向，拓展公司在高端科技领域的布局，为未来业务增长开辟新赛道。 3. 目前国内半导体封测市场日趋成熟，公司如何与长电、华天等头部企业竞争？未来如何在全国封测市场抢占份额并保持较高的利润率？ 答:公司与上述企业在产品品类和生产工艺上存在差异。基于高端光电传感器几乎被欧美和日本的企业垄断，国产化率低的现状，公司依托30年的透明封装经验，聚焦光集成传感器封测这一细分赛道，通过差异化技术路线与产品定位，避开同质化红海竞争。在光子集成封测领域，公司拟对标长电，技术、产品规划路径为：光传感→光通信→光计算，成为光子集成封测领域的国内龙头。 未来，公司将积极培养战略客户，通过资本、技术绑定强化协同效应，实现资源互补与价值赋能，携手突破行业关键“卡脖子”技术瓶颈，携手推进国产替代进程，携手占领国际市场，打造半导体光集成传感器产业链闭环，实现生态乘数效应。 4. 今年以来，黄金、铜等贵金属价格上涨，公司原材料采购怎么锁定成本？是通过现货层面与上下游供应商的联动进行锁定还是通过期货层面进行锁定？公司与厦门的建发、国贸等几家贸易商是否有合作？ 答:针对贵金属采购，公司采取“现货采购与期货采购相结合”的灵活模式，并与公司实际产能规划、订单交付周期及市场价格波动趋势相匹配。公司与厦门国贸有开展期货方面的合作。 5. 目前无人机发展趋势很强劲，请问公司在无人机领域有关业务布局和进展？ 答:公司的激光雷达探测传感器件及TOF传感器件可高效适配
--	--

	无人机悬停控制、障碍物规避等核心应用场景。目前，相关产品已在国内知名品牌的无人机上应用，公司也在向更多的客户提供样品测试。 6. 公司在光集成传感封测领域布局深远，能否详细介绍一下现在和未来的产能是如何规划的？ 答：厦门光集成传感封测智能制造基地是公司打造的第一个标准化基地，人才已前瞻储备到位，该基地场地规划产能为100KK/月，已建成产能40KK/月，自今年投产以来客户密集验厂导入、产能利用率逐步爬坡，目前产量约20KK/月。未来，公司将以厦门基地为标杆样板，根据客户需要在全球复制。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	本次活动不涉及未公开披露的重大信息。
附件清单（如有）	
日期	2025年10月23日